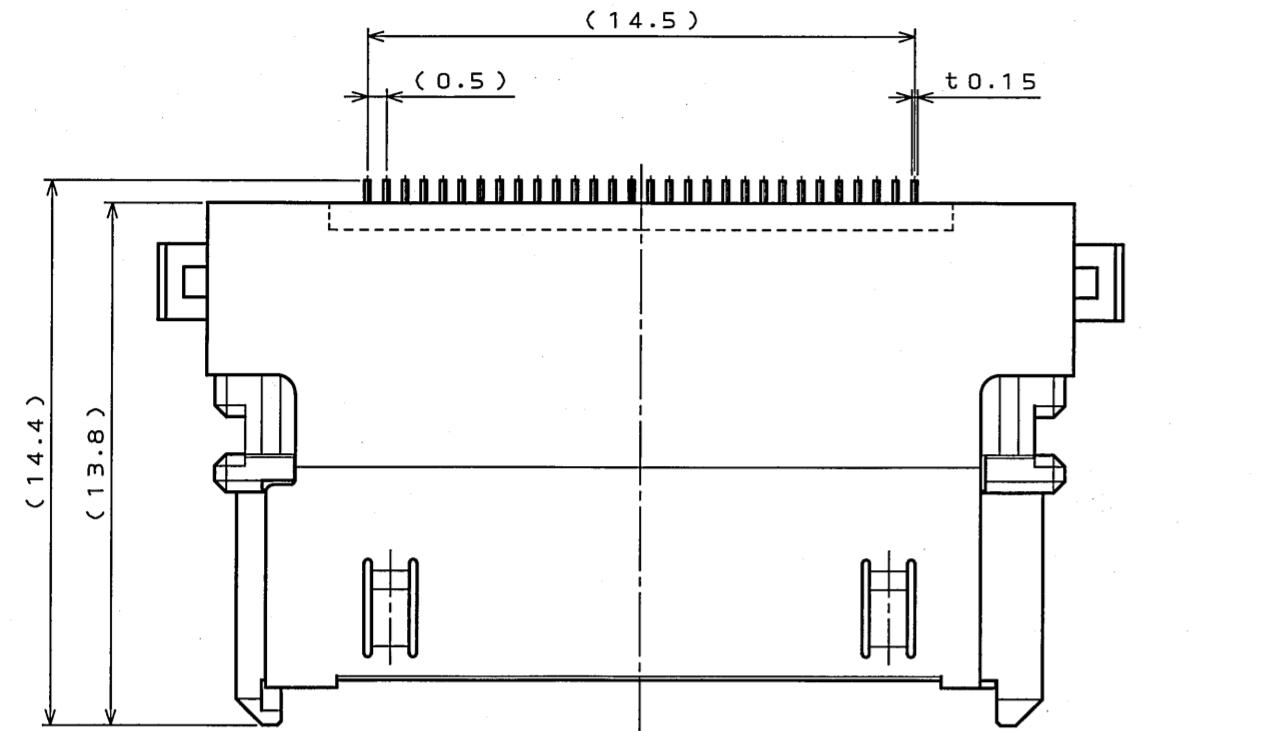
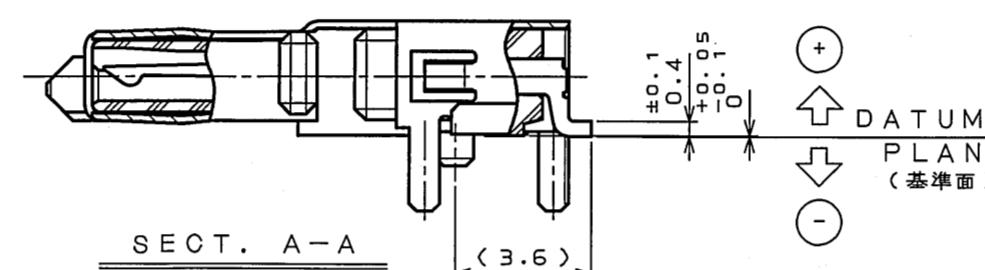


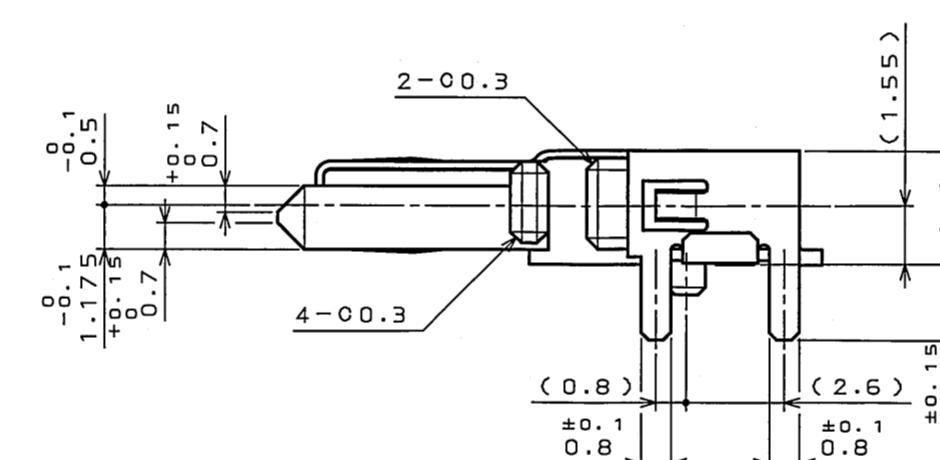
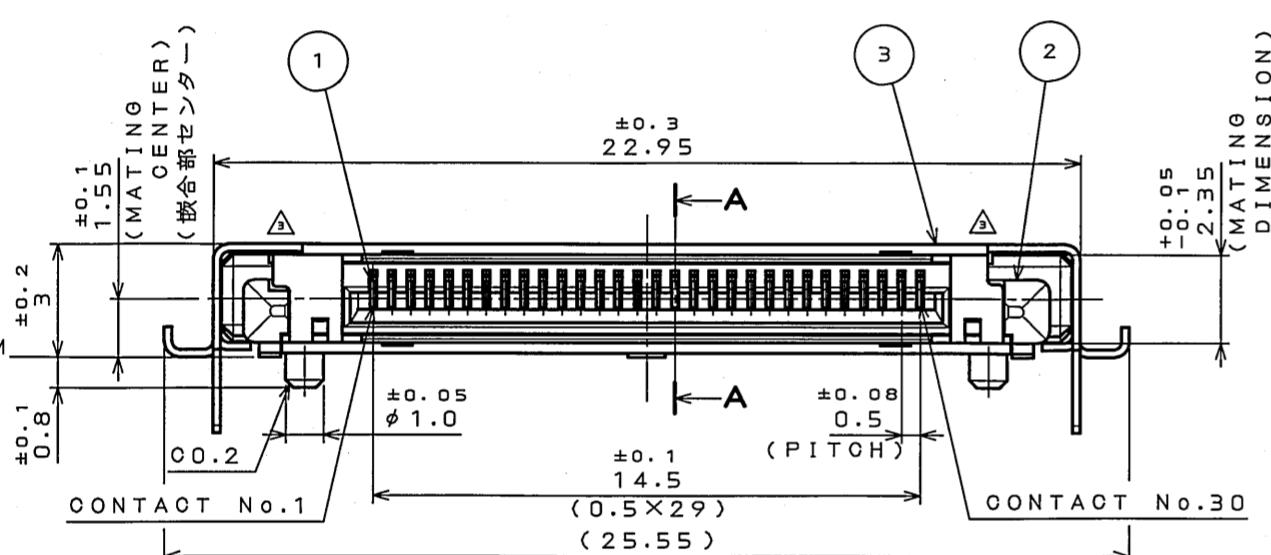
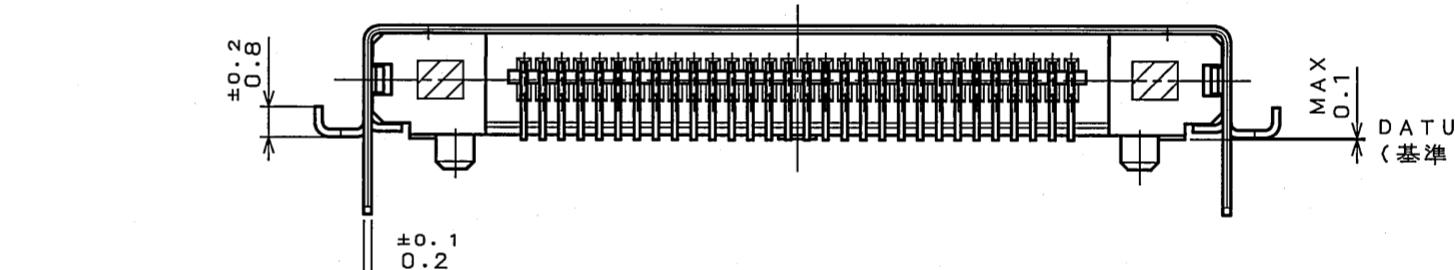
版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閱 APPD.	承認 APPD.
2	1.Jul.2004	055417	ADDED NOTE 4		Y.KUROKI	—	H.AMEMIYA
3	15.Mar.2005	056934	SHAPE CHANGE		Y.KUROKI	—	<i>Y. Haga</i>



MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図(参考)



APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
适合基板尺寸 (参考)



NOTE1. + AND - DENOTE ARE DIRECTION OF SMT TOLERANCE TERMINAL DIMENSION IS 0,
AND DEVIATION (DIMENSION BETWEEN MINUS VALUE & PLUS VALUE) SHALL BE 0.1 MAX.
2. LAND MARK BOTH SIDES OF P. C. B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
3. PLEASE NO PATTERNING IN SLANT AREA.

4. USE JIG OR DISPOSABLE BACKUP BOARD FOR DATUM PLANE (3 AREA) RETENTION

4. USE JIG OR DISPOSABLE BACKUP BOARD

+0.05
-0.1

注1. SMT公差部のプラス、マイナスの方向を示す。端子寸法は "0.1" であり、

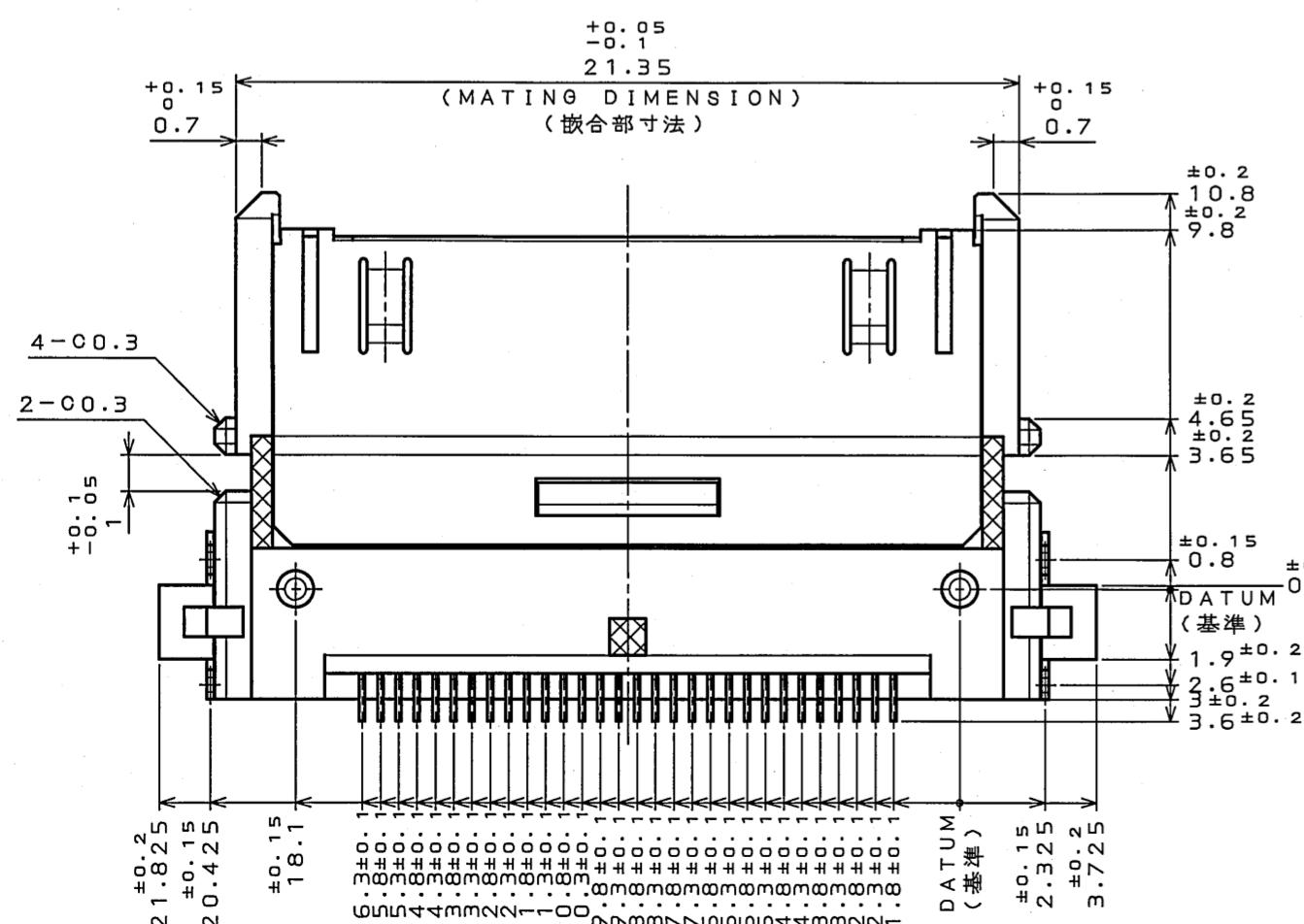
公差内におけるバラつき(1コネクタ内の

2. ランドは基板の両側に設けること。また、スルーホールの穴はスルーホールミットであること。

フロントは基礎の構造に設計すること。また、スルーホールの入はスルーホールメッシュであること。

3.図に示す範囲をパターン禁止領域とする。

4. 図に示す範囲は倒れ防止の捨て基板とする。図示の位置にVカットを入れ、リフロー後に折り取ること。



3	SHELL	1	STAINLESS STEEL	NICKEL PLATING THROUGH HOLE AREA: TIN PLATING	
2	INSULATOR	1	9T NYLON	(BLACK)	UL94V-0
1	CONTACT	30	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL SMT AREA: GOLD FLASH OVER NICKEL	GOLD: 0.1μm MIN GOLD FLASH: 0.03~0.1μm
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-3285		第1版(ORIGINAL DATE) 4.Mar.2004		尺度(SCALE) 5: 1	シリーズ(SERIES) DD1
		製図 DR.		名称(TITLE) DD1B030HA1	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS JAE INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	Y.KUROKI		
寸法(DIMENSION)		査閱 APPD.			
±	X° ±				
·X	±	X°X' ±			
·XX	±				
·XXX	±				
				質量(MASS)	
					SJ100602

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[JAE Electronics:](#)

[DD1B030HA1R500](#)